



# Automatic cleaning system DCS1441

## 晶圆经切割机加工后的洗净与干燥

### 强化洗净能力的半自动洗净设备

适用于半自动切割机等晶圆切割后的洗净与干燥。

透过最大吐出压力达11.8Mpa的高压洗净与使用者自行设定的洗净工序(洗净手臂旋转速度与清洗台旋转次数),可以提供多种加工物所需的更佳洗净方式。

此外,还可搭配流水洗净、水气二流体洗净、高洁净水气二流体洗净等选配功能。可大幅减少晶圆上残留的矽碎屑。



### 适用于多种加工物

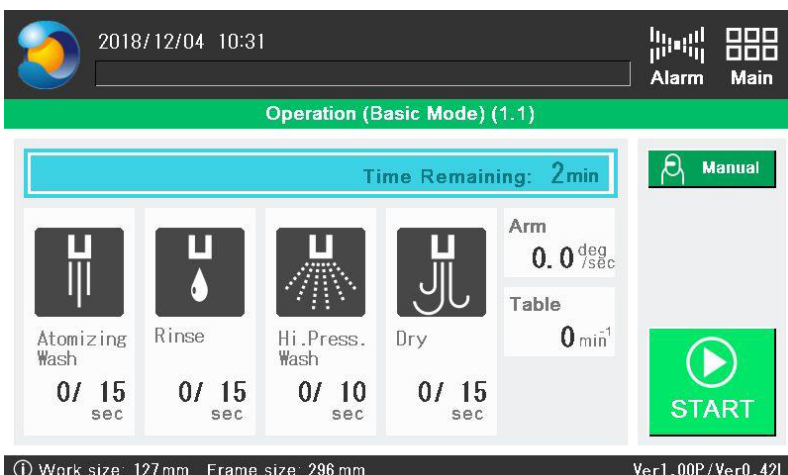
φ5 ~ 8 英寸用胶带铁框,

透过选配,最大可对应方形250mm的加工物

### 操作简单

可在液晶显示面板上简单地设定进行洗净工序。

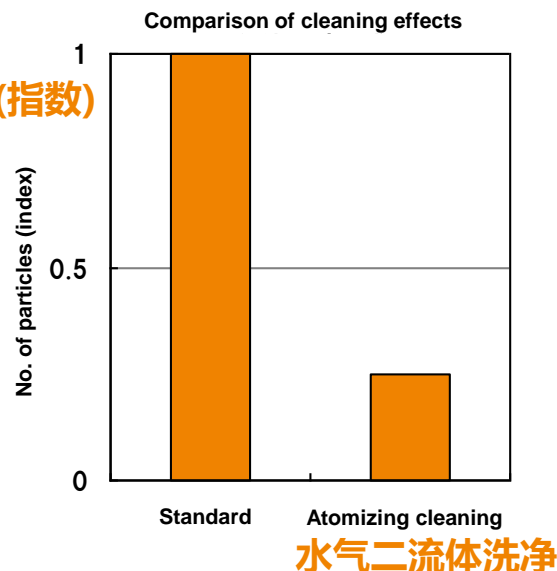
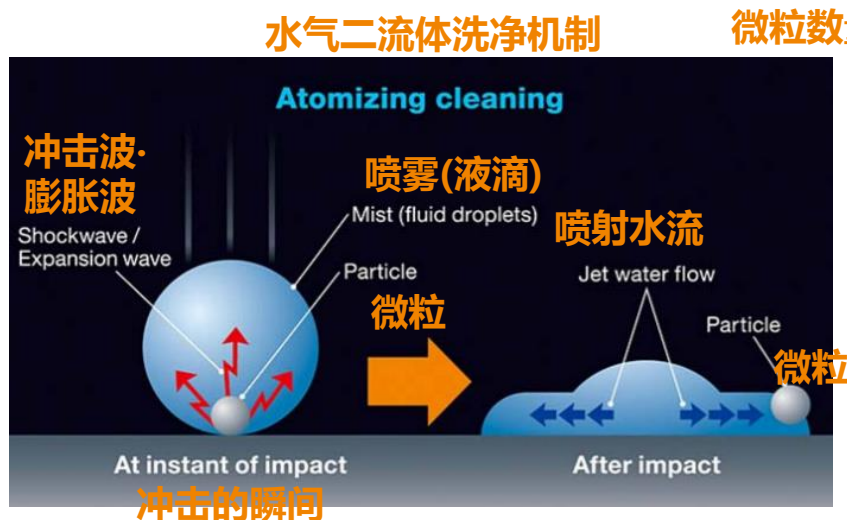
搭载简易模式也可在仅设定加工物尺寸、清洗台旋转次数、洗净时间之下进行洗净程序。



洗净程序设定画面

### 水气二流体洗净 (选配)

采用独自开发的水气二流体洗净喷嘴以实现较高洗净效果。在高速气流下使纯水呈现微粒化的水珠,经由喷射能有效去除砂碎屑。此外,DCS1441还可搭配使用洗净效果更高的高洁净水气二流体洗净功能



### 减少占地面积

缩减宽度的省空间设计

Specifications		
Specification	Unit	DCS1441
Max. workpiece size	-	ø8"
Max. frame size	-	2-8-1
Table rotation speed	min <sup>-1</sup>	100 – 3,000
Cleaning/drying time setting	s	0 - 999
Cleaning nozzle speed	°/s	1 – 37.5
Cleaning range	mm	ø355 (up to 250 mm square)
Cleaning pressure range	Mpa	2.3 – 11.8
Machine dimensions (W x D x H)	mm	400 x 600 x 1,380
Machine weight	kg	Approx. 130

#### ■使用条件

- 请使用大气压露点-15℃以下, 残留油分为0.1 ppm, 过滤度0.01 μm/99.5%以上的洁净压缩空气。
  - 请将放置机器设备的实验室室温设定在20℃~25℃之间, 便将波动范围控制在±1℃以内。
  - 其他, 请避免设备受到撞击及外界的可感震动。另外, 请勿将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油污的装置附近。
  - 本装置会用到水。
- 因对应可能会发生漏水现象, 请将本装置安装在有防水性的地板及有排水处理的场所,
- ※ 为改良设备, 本公司可能在预先不通知用户的情况下就本规格实施变更, 因此请仔细确认规格后发出订单。
- ※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询, 请与本公司业务部门联络。